



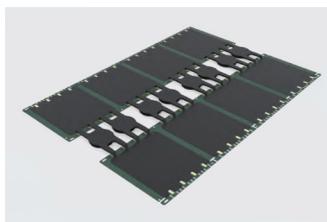
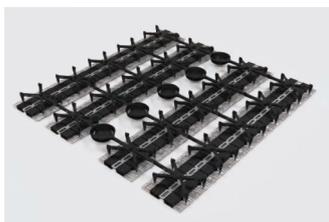
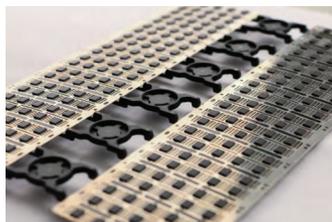
**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

## Полуавтоматическая установка герметизации электронных компонентов методом литья пластика под давлением IDEALab 3G



IDEALab – это система герметизации пластиком электронных компонентов методом литья под давлением (transfer molding). Загрузка комплектации и таблеток пластика осуществляется вручную, а сам процесс выполняется автоматически в соответствии с заданными параметрами рабочей программы.

Установка предназначена для мелкосерийного и опытного производства. С ее помощью можно герметизировать пластиком интегральные микросхемы, микромодули и дискретные компоненты. Отливка осуществляется в пресс-форме на групповых заготовках – выводных рамках с предустановленными кристаллами полупроводниковых компонентов.



Параметры	IDEALab 3G
Габариты выводных рамок	Длина 100–300 мм; ширина 25–100 мм
Габариты таблеток заливочного пластика	Диаметр: 11, 13, 14, 16 и 18 мм; высота: диаметр + 2 мм
Усилие замыкания пресс-формы	80, 120 и 170 т
Давление литья	3 т (4 т для 170-т прессы)
Габариты прессы	570 x 570 x 1750 мм
Электропотребление	3 фазы; 380 В; 50/60 Гц
Потребляемая мощность	12–24 кВт
Сжатый воздух	5–7 бар, 500 л/мин
Вытяжка	12 м³/мин
Система вакуумирования и вакуумный насос	Опция
Габариты	1990 x 1317 x 2170 мм
Вес	4000 кг / 80-т пресс; 4200 кг / 120-т пресс; 4800 кг / 170-т пресс

ООО «ЛионТех-С»  
mail@liontech.ru



Звонок по России бесплатный:

**8 800 555 6889**

**8 (812) 309-27-37**

**8 (495) 646-14-76**

**www.liontech.ru**

*Технологическое оборудование и расходные материалы  
для производства электроники*